

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	市场投资者
时间	2026年4月15日 15:00-17:00
地点	全景网投资者关系互动平台 (https://ir.p5w.net/)
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理李焕昌; 独立董事李剑; 副总经理兼董事会秘书刘力; 财务总监李纳; 证券事务代表陈晓芬。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>深圳市昌红科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会于 2026 年 4 月 15 日在全景网投资者关系互动平台举办。本次业绩说明会以文字互动方式与投资者进行沟通交流, 主要内容如下:</p> <p>1、大股东, 您好, 想问一下为何所有业务合作和增长点都是大大的利好, 但是收入和利润却在下降。公司预计在什么时间会在报表上反映出新增长点的增长。和市场预期一致</p> <p>回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司当前正处于业务结构优化及新业务拓展阶段。报告期内, 受部分传统业务波动及新业务投入增加等因素影响, 经营业绩出现阶段性承压。</p> <p>公司当期重点推进的医疗耗材、自动化及相关精密制造业务, 整体处于客户导入、产能建设及规模化放量的过程中, 新业务从订单获取到收入确认通常存在一定周期。同时, 前期投入在短期内对利润形成一定压力, 但有助于公司长期竞争力的提升。</p> <p>未来, 公司将持续优化业务结构, 推进重点项目落地, 提高运营效率, 努力提升整体盈利能力。相关业务的具体进展及经营情况, 请以公司后续披露的定期报告及公告为准。</p> <p>2、领导, 您好! 我来自四川大决策。请问, 公司除已获得的晶圆厂客户外, 公司是否在拓展其他晶圆厂、硅片厂、封测厂客户? 当前处于小批量验证阶段的产品有哪些, 预计何时转为批量供货?</p>

回复：尊敬的投资者，您好！公司在巩固现有客户合作的基础上，持续关注半导体产业链相关机会，积极推进与晶圆制造、硅材料及封装测试等领域客户的业务交流与合作拓展。相关客户拓展工作正在有序推进中。

目前，公司部分半导体相关产品已进入客户验证或小批量试用阶段。鉴于半导体行业对产品性能、稳定性及一致性要求较高，相关产品从验证到规模化供货通常需要经过较长周期，其具体进展受客户验证节奏、产品应用场景等多方面因素影响。

公司将根据客户需求稳步推进相关项目进展，持续提升产品与工艺能力。关于具体客户合作及业务进展情况，请以公司披露的定期报告及公告为准。

3、公司进军半导体耗材决心有多大？有没有信心在未来三五年取得像在医疗耗材和精密模具般的成就？

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视半导体相关精密制造及耗材领域的发展机会，将其作为重点关注和持续投入的方向之一。依托公司在精密模具设计制造、微结构加工及高洁净生产管理等方面的技术积累，公司正积极推进相关领域的技术储备与业务拓展，并围绕客户需求开展前瞻性布局。

目前，公司在半导体相关业务方面仍处于持续投入及市场开拓阶段，部分项目已进入客户验证或导入过程中。鉴于该领域技术门槛高、验证周期长、产业链协同要求高，相关业务从投入到形成规模化收入仍需一定时间。

未来，公司将根据行业发展趋势及自身资源禀赋，稳步推进相关业务发展，不断提升核心竞争力。关于具体经营进展及业绩情况，请以公司披露的定期报告及公告为准。

4、为什么公司近年公布的和一些芯片大厂的合作时候，数据总是不清不楚，而且这种状况一直都是在持续。是不是因为数额太少而不好意思说。还是有其他原因，请问一下，载具业务目前是否有何中芯国际合作，或有合作的厂商目前预计可以达到多少年化收入及利润，后续3年对这块业务的收入预计会增加至达到多少？国内所有芯片大厂是否都可以达成合作

回复：关于公司与芯片大厂合作信息披露较少的情况，主要系半导体行业对供应链信息存在严格的保密要求。晶圆厂客户通常对供应商的产品规格、采购规模及合作细节设有明确的保密要求，公司需遵守相关约定，因此在客户名称及具体订单金额等方面披露相对审慎。同时，公司半导体载具等产品目前仍处于导入及逐步放量阶段，整体规模较小，订单以分批交付为主，尚未形成稳定、可清晰量化的年化收入与利润规模。

在业务进展方面，公司相关产品已进入部分国内主流晶圆厂供应体系，并取得一定份额，目前处于持续验证及逐步放量过程中，单一客户贡献整体水平较小，对公司整体业绩影响有限。

未来随着客户导入深化及产品品类拓展，业务规模有望逐步提升，但具体放量节奏取决于下游客户认证进度及产能规划，存在一定不确定性。

从行业规律来看，半导体耗材供应商通常需经历较长验证周期，并在单一或少数客户中逐步提升份额后，再向更多客户复制拓展，公司亦将按照该路径稳步推进。目前尚无法对未来三年相关业务的具体收入及利润规模进行准确预测，公司将持续提升技术能力与产品质量，积极拓展客户资源，并根据业务进展情况依法依规履行信息披露义务。

**5、半导体业务国产替代进展预期如何，何时能贡献利润!!!
别天天跟投资者吹牛**

回复：公司半导体业务目前处于国产替代导入及逐步放量阶段，相关产品已进入部分国内主流晶圆厂供应体系，并在个别细分领域实现小批量供货，但整体仍以验证及导入为主。鉴于半导体载具及相关耗材具有认证周期长、技术门槛高的行业特点，从产品导入到规模化放量通常需要较长时间，当前国产替代进展整体呈现稳步推进的态势。

从盈利情况来看，现阶段该业务收入规模相对有限，同时前期研发投入、产线建设及客户验证成本较高，对公司整体利润贡献尚不显著。随着后续客户认证逐步完成、产品品类不断丰富以及单一客户供应份额提升，业务规模有望逐步扩大，盈利能力亦将逐步改善。综合判断，该业务短期内对公司业绩贡献仍较为有限，预计需经历一定周期的持续投入与放量后，方有望逐步实现规模化收入并对利润形成积极贡献。

公司将持续推进相关技术能力建设与市场拓展工作，积极把握半导体产业发展机遇，但相关业务的具体放量节奏、收入及盈利水平仍取决于客户认证进度、市场需求及行业环境等因素，存在一定不确定性。公司将严格按照信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

6、请问：上市公司发行的 4.6 亿元可转债还有不到一年就要到期，目前溢价率高达 105，之前一直不下修，是否公司近期已经开始考虑下修并准备下修到底了？如果不选择下修，公司还有其他什么办法解决转债？

回复：公司高度关注可转债事项进展，并将严格按照法律法规及募集说明书约定审慎推进。转股价格的调整（包括是否下修及下修幅度）需综合考虑公司基本面、市场环境、股价表现以及全体股东利益等多方面因素，并履行相应的内部决策程序及信息披露义务。

截至目前，公司尚未就转股价格下修事项形成明确方案，未来如触及相关决策条件或公司作出具体安排，将严格按照规定及时履行审议程序并对外披露。

如未实施转股价格下修，公司亦将结合资金状况、融资安排及

债券持有人利益等因素，依法依规通过包括到期赎回、提前赎回或其他合规方式妥善处理可转债，切实维护公司及投资者整体利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

7、公司在 IVD（体外诊断）精密模具及一次性医疗耗材领域的订单饱和度如何？能否介绍一下公司在 AI 辅助生殖/医疗机器人方面的具体研发进展及商业化落地时间表？

回复：公司在 IVD 精密模具及一次性医疗耗材领域经营情况正常，订单整体保持稳定，产能利用处于合理水平，具体经营数据请以公司定期报告披露为准。

在相关新业务方向上，公司主要依托既有精密制造及模具技术能力进行前瞻性技术储备与业务拓展，尚未形成规模化收入，对公司业绩影响较小。相关业务的商业化进展及时间存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

8、随着新能源汽车渗透率的提升，公司汽车精密模具业务的订单是否出现了明显增长？主要配套的国内外客户有哪些新的突破？

回复：根据公司战略发展，目前公司还是着力重点发展医疗板块、智能制造板块及半导体板块业务，以精密模具为核心稳定注塑交付为依据加速深入拓展新老客户。

9、您好。作为投资者，我注意到贵公司 2024 年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点，支持理性决策。缺少视频直播或回放可能使投资者信息获取不够充分与直观。请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？感谢解答。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的建议与关注。公司重视与投资者的沟通交流，目前业绩说明会主要通过文字问答等方式开展。关于采用视频直播并提供会后回放的建议，有助于提升信息传递的充分性与直观性，公司已予以关注，后续将结合实际情况和投资者需求进行评估与研究，不断优化投资者沟通方式。感谢您的理解与支持。

10、网上非常的多的投资者说你整天吹牛，忽悠投资者，公司股价长期低迷，反复割投资者！你对此怎么解释

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与反馈。我们理解投资者对公司股价表现的关切。公司始终严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，不存在误导性陈述。二级市场股价受宏观环境、行业周期及市场情绪等多重因素影响，存在一定波动性。

公司将持续专注主业发展，努力提升经营质量与盈利能力，同

	<p>时不断加强与投资者的沟通交流，积极传递公司长期价值。感谢您的理解与支持。</p> <p>11、股价怎么不涨？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与反馈。我们理解投资者对公司股价表现的关切。公司始终严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，不存在误导性陈述。二级市场股价受宏观环境、行业周期及市场情绪等多重因素影响，存在一定波动性。 公司将持续专注主业发展，努力提升经营质量与盈利能力，同时不断加强与投资者的沟通交流，积极传递公司长期价值。感谢您的理解与支持。</p> <p>12、公司口口声声说加强跟投资者沟通，可是董秘长期不接电话，建议换个董秘。 回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注与建议。对于您反映的沟通不畅问题，公司高度重视并表示歉意。公司始终重视与投资者的沟通交流，已安排专人持续优化投资者热线接听及信息反馈机制，努力提升沟通的及时性与有效性。 公司管理层及相关岗位均按照规范履行职责，后续将进一步完善多渠道沟通方式（如投资者热线、互动易平台等），不断提升投资者服务水平。感谢您的理解与支持。</p> <p>13、你好，请问半导体晶圆载具是否已有订单，并且开始供货了，如果有相关数据一季报会有体现吗 回复：公司半导体业务相关产品已进入部分国内主流晶圆厂供应体系，并取得一定份额，目前处于持续验证及逐步放量过程中，单一客户贡献整体水平较小，对公司整体业绩影响有限。未来随着客户导入深化及产品品类拓展，业务规模有望逐步提升，但具体放量节奏取决于下游客户认证进度及产能规划，存在一定不确定性。关于具体客户合作及业务进展情况，请以公司披露的定期报告及公告为准。</p>
附件清单	无
日期	2026年4月15日